



2025年6月2日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ  
代表者名 代表執行役社長 CEO 明間 純  
(コード番号 6740 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 CFO 平林 健  
(TEL. 03-6732-8100)

### (開示事項の変更) PanelSemi Corporation (台湾) との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2025年2月12日付「先端半導体パッケージング及びセンサー技術を手掛ける PanelSemi Corporation (台湾) との資本業務提携のお知らせ」にて、PanelSemi Corporation (台湾、以下「PanelSemi」といいます。) との間で、JDIによる出資契約及び今後の協業に関する覚書(MOU)を締結したこと(以下、これらを合わせて「本資本業務提携」といいます。)を発表いたしましたが、このたび、両社の協議の結果、出資契約の実行は見送ることとするものの、協業については今後も継続することで合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本資本業務提携の変更の理由

近時の半導体分野を取り巻く地政学的リスクのさらなる高まりや、グローバル経済環境の急激な変化を踏まえ、資本提携のスキームを再検討する必要があるとの認識で両社が一致し、出資契約について、現時点では実行を見送ることといたしました。また、MOUには出資契約と連動する条項が含まれていることから、出資契約の実行見送りに伴い、MOUについても両社合意のもと終了することといたしました。

なお、先端半導体パッケージング用基板の開発及びセンサー事業の推進については、今後も個別の合意に基づき、両社間での協業を継続してまいります。その一例として、本日付プレスリリース「JPCA Show 2025にて先端半導体パッケージング基板を出展ー世界トップクラスのガラス基板加工技術を、高精細 RDL on セラミック基板に活用ー」のとおり、両社は2025年6月4日～6日に東京ビッグサイトで開催される「JPCA Show 2025 国際電子回路産業展」において、セラミック基板上に高精細 RDL (Re-Distribution Layer) 配線を形成したサンプルを共同展示いたします。

##### 2. 業績に与える影響

本資本業務提携の変更が2026年3月期の業績に与える影響は軽微です。

なお、当社は現在、2026年3月期の連結業績予想を開示しておりません。

以 上